



主办单位:安徽省档案馆

产业兴则城市兴,创新强则根基强。2026年安徽省人民政府工作报告关于“十五五”时期主要目标和重大任务部分中,提出大力发展智能网联新能源汽车、新一代信息技术、人工智能等十大新兴产业,勾勒出包含集成电路在内的安徽新一代信息技术产业从技术突破到集群壮大、从补齐短板到迈向一流的发展蓝图,而这一蓝图的核心承载地,自然少不了省会合肥。

循着政策指引回望,安徽合肥,这座以科教立城的城市,用持之以恒的坚守与深耕,将集成电路产业的“种子”培育成枝繁叶茂的“森林”,从默默无闻到崛起为拥有世界级“芯屏”产业集群的“中国IC之都”,书写了一段政企协同、产学研联动的创新奋进史。合肥的“芯”路历程,在安徽省档案馆的馆藏档案中,得到了较为详实的印证与解答。

积极布局,播下“芯”种子

20世纪80年代,集成电路作为信息技术产业的核心,被视为国家科技实力的重要标志。彼时,国内集成电路产业尚处于起步阶段,安徽凭借雄厚的科教资源,敏锐捕捉到这一产业机遇,率先提出在合肥布局大规模集成电路厂的设想,安徽省档案馆馆藏的一份1982年10月30日安徽省人民政府报送国务院并相关部委的《关于要求在合肥市建设大规模集成电路厂的报告》便是直观的印证。报告中指出:“合肥市是国家确定的重要科教基地,现有中国科技大学、电子工程学院、合肥工业大学等十三所大专院校,还有中国科学院光机所、等离子体所、智能所、固体物理所及省、市数十个研究单位;电子工业部部属六个研究所均在我省,其中1443所(混合集成电路研究所)设在合肥,1016所也将迁来该市。这些单位拥有比较雄厚的科技力量,可以为大规模集成电路厂提供良好的协作条件。”

此外,报告中还提及:“中国科技大学正在合肥市建设同步电子辐射装置,建成后,可提供高亮度、高稳定度的辐射光,广泛应用于超大规模集成电路的光刻显微技术。”这些都为合肥集成电路产业的长远发展埋下了重要伏笔。

这份跨越40余年的档案,不仅彰显了安徽省委、省政府的战略远见,更记录了合肥发展集成电路产业的先天优势——科教资源富集、科研力量雄厚,这些“基因”始终贯穿合肥“芯”产业的发展全过程。

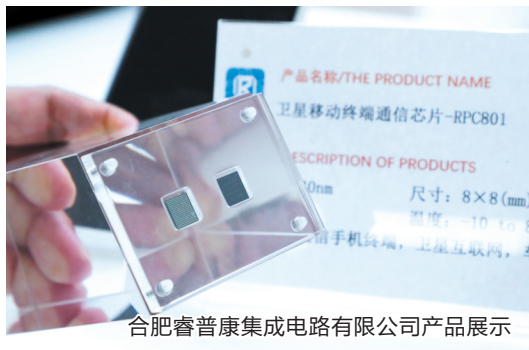
政策护航,培育“芯”沃土

步入21世纪,国家对集成电路产业的支持力度不断加大,国内市场需求持续增长,集成电路产业迎来发展的黄金机遇期。安徽省档案馆馆藏的《对安徽省政协九届四次会议第0553号[工业引领 走新型工业化道路 全力以赴做大做强安徽省及合肥市的集成电路产业]提案的答复》档案,记录了合肥集成电路产业起步破局的重要阶段。

这份2006年由安徽省信息产业厅出具的答复,回应了当时合肥集成电路产业的发展布局与成效。答复记载,“十五”以来,安徽集成电路产业的发展环境在各级政府的重视下得到较大改善,“特别是合肥市加大力度发展集成电路产业取得重大突破”。

其中,当时的合肥经济开发区(合肥经济技术开发区)和合肥高新开发区(合肥高新技术产业开发区)成为产业起步的核心载体。答复中记载,合肥经济开发区微电子产业基地建设已两年多,总占地面积约500亩,已高标准完成道路、供水、供电、通讯、排水“五通一平”,明确以集成电路项目为主,兼顾发展印刷电路板(PCB)、SMT加工、混合集成电路、电子材料基板等相关产业,“目前,年产1亿只集成电路封装线已建成投产”。与此同时,合肥高新开发区则形成了集成电路设计企业的集聚态势,为产业发展构建了初步的产业链雏形。

值得注意的是,这一阶段的发展,始终延续了“协作”理念——政府、科研机构、企业协同发力,形成了上下联动、政企联动、产学研联动的良好格局。这种协作精神,成为合肥集成电路“芯”产业持续发展的重要动力。



合肥睿普康集成电路有限公司产品展示

初心不辍“芯”路致远

——合肥集成电路产业的奋进之路



迭代深耕,筑牢“芯”根基

进入新时代,合肥集成电路产业迎来跨越式发展,从初步集聚到形成完整产业链,从跟随模仿到部分领域领跑,这份成长,既是对档案中最初愿景的践行,更是安徽(合肥)持续发力、久久为功的成果。

芯片和我们的生活息息相关。打个形象的比喻,芯片就是“工业血液”,没有芯片,手机、电脑、汽车等就没有办法运行。如今的合肥,已形成以新站高新区为核心的集成电路产业集群,构建了从IC设计、晶圆制造、芯片封装、成品测试到终端应用的完整产业链生态,成为全省首个同时拥有硅基和多品类第三代化合物半导体、产业链上下游环节最齐全的产业园区。截至2025年11月,新站高新区已汇聚集成电路上下游产业链产业超60家、从业人员近万人、总投资超千亿元;合肥综保区作为核心承载地,集聚了众多集成电路产业链重点企业,区内企业授权发明专利数量累计突破1000件,依旧保持全市集成电路产业单位面积成效最显著的区域地位,产业能级持续提升。

晶合集成的发展历程,是合肥“芯”产业崛起的生动案例。这家位于合肥综保区的企业,成立于2015年,是合肥建投与力晶创投合资成立的安徽省首家12英寸晶圆代工企业,打破了当时省内高端芯片制造依赖外部的局面。从2017年正式投产,到2023年在科创板挂牌上市,创下“安徽史上最大IPO”纪录,再到2024年显示驱动芯片全球市场占有率领先地位,成为国内第三、全球前十的晶圆代工厂,晶合集成的快速发展,彰显了合肥“芯”产业的发展速度与实力。

除了晶合集成这一“链主企业”,合肥还培育出了一批细分领域的龙头企业,形成了“百花齐放”的产业格

局。顾中科技作为境内收入规模最大的显示驱动芯片封测企业,在全球显示驱动芯片封测领域位列前三,其开发的“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”,实现了技术突破与成本控制的双重目标;汇成股份作为最早一批实现12英寸晶圆金凸块量产的显示驱动芯片封测企业,打破了境外垄断。这些企业的崛起,构建起完整的产业链闭环,让合肥“芯”产业的竞争力持续提升。

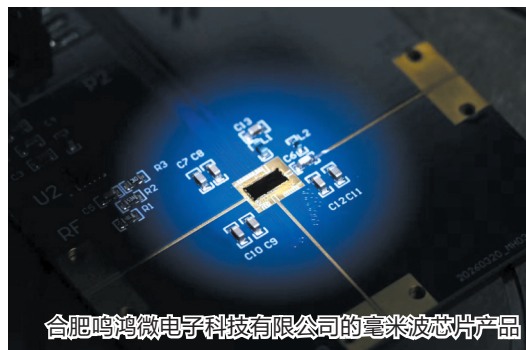
产业的持续发展,离不开创新生态的支撑。2025年12月,合肥新站集成电路产学研创新联盟正式成立,同步启动“新站NANO”公共服务平台(新站微纳加工测试公共服务平台),构建起“政产学研金服用”深度融合的协同创新生态。联盟由北航合肥创新研究院担任理事长单位,汇聚38家会员单位,通过搭建常态化交流渠道,打通创新壁垒,促进资源互补;“新站NANO”平台则集芯片设计、加工、封测、中试于一体,为科研机构与企业提供全流程服务,加速科研成果转化。同时,校企合作持续深化,北航合肥研究院与晶合集成、安徽职业技术大学分别签署人才培养协议,构建起多层次、贯通式的人才供给体系,为产业发展储备智力资本,这与1982年档案中“依托科教资源、强化协作支撑”的理念一脉相承。

如今,合肥正持续深化“芯屏”主导产业体系建设,推动产业链、创新链、人才链深度融合,全力打造具有国际竞争力的世界级“芯屏”产业集群。未来,合肥“芯”力量将继续以创新为帆,在国产替代、全球领跑的道路上勇毅前行,书写更多属于中国“芯”的辉煌篇章,为国家科技自立自强贡献合肥力量。

撰稿:安征 吴承江 图片:黄洋洋 高斌



12英寸晶圆切割后硅片展示



合肥鸣鸿电子科技有限公司的毫米波芯片产品